高周波数帯次世代移動通信に向けた c 軸平行 ScAlN 薄膜 / 単結晶 LiNbO₃ 板構造をもつ縦型漏洩 SAW フィルタの開発

山梨大学 鈴木雅視

Longitudinal Leaky SAW Filter Consisting of c-axis Parallel ScAlN film / LiNbO₃ Single Crystal Substrate for High Frequency Next Generation Mobile Communications

Masashi Suzuki University of Yamanashi

縦型リーキーSAW (Longitudinal Leaky SAW: LLSAW) は他の SAW 伝搬モードより高い 結合係数,高位相速度を有するため,高周波フィルタ応用に適した SAW 伝搬モードである。 しかし, 圧電基板単体構造を用いた SAW デバイスでは,LLSAW は伝搬減衰が大きくなり, 低 Q 値となる。そこで本研究では, "高い SAW 位相速度・高い電気機械結合係数・低い 伝搬減衰"の両立する「結晶方位,分極方向を制御した希土類 AIN 薄膜 / 圧電単結晶基板 構造を用いた縦型漏洩弾性表面波 (LLSAW) デバイス」の開発を試みた。巨大 ScAIN 薄膜を 様々な圧電単結晶基板上に積層した構造での SAW 伝搬特性の理論解析から,ScAIN 膜を LiNbO₃ 基板に装荷した場合,結合係数と伝搬減衰はトレードオフの関係にあることを確 認した。一方, c 軸平行 ScAIN 膜を水晶に装荷した構造では高位相速度,ある程度大きな 結合係数,低伝搬減衰が両立することを明らかにした。

Longitudinal leaky SAW (LLSAW) devices are more suitable for applications to high frequency filters than other mode SAW devices, because of their high electromechanical coupling factor (K^2) and high phase velocity. However, the LLSAWs on monolayer piezoelectric substrates possess high attenuation, which cause a low Q factor. We expected that the high K^2 , high phase velocity, and low attenuation in LLSAW would be obtained by loading the giant piezoelectric ScAlN film on the piezoelectric single crystal substrate. In this study, the LLSAW propagation characteristics on ScAlN films/piezoelectric single crystal substrates (Quartz and LN) were investigated to determine the optimized layered structure for LLSAW devices. From the results of theoretical SAW propagation analysis, LLSAWs on c-axis oriented or parallel ScAlN films / LiNbO₃ substrate did not have high K^2 and low attenuation simultaneously. On the other hand, LLSAWs propagating on c-axis parallel ScAlN film / AT-cut or X-cut quartz possess have high phase velocity, relatively high K^2 , and low attenuation.

1. はじめに

逆圧電効果を利用して弾性表面波を励振する SAW デバイス (図1)は,携帯電話等の周 波数フィルタとして利用され,移動体通信産業を支える極めて重要な役割を果たしている. 現在の移動通信システムの周波数域は2.2GHz 以下であるが、スマートフォン等の急速な発達 に伴い、通信大容量化や高速化に向け、3GHz 以上を周波数帯域とした次世代移動通信システ ムへの移行が検討されている.これを実現する ためには、周波数フィルタ用 SAW デバイスに は高い SAW 位相速度(高周波動作)、高い電気 機械結合係数(広帯域幅)、低い SAW 伝搬減 衰(高Q値)が要求される。

縦型漏洩弾性表面波 (LLSAW) の特徴は速い SAW 位相速度である^[1]. 他の伝搬モードより2 倍程度速度が大きく,高周波動作に適した伝搬 モードである.しかし,弾性波を基板内部へ放



射しながら伝搬するため、非常に大きな伝搬損失をもつという欠点があり、従来構造(図 1(a))では不適切な伝搬モードであった.そこで、垣尾らによって提案されたのが、圧電 単結晶基板上に基板よりも音速が速いアモルファス AIN 薄膜を装荷した LLSAW デバイス である^[2].弾性波は速度の速い層に集中するという性質があり、高音速膜装荷により LLSAW での伝搬減衰低減を達成している.しかし、装荷した薄膜がアモルファス構造で あるがゆえ、圧電性が有しないために SAW 伝搬に寄与せず、電気機械結合係数が小さい といった課題があった.

これらの課題に対し,装荷する薄膜に「高い圧電性,高音速を有する結晶性薄膜を用いる」,かつ薄膜内でのSAW 伝搬に寄与する圧電性の大きさ,正負符号は結晶方位や分極 方向で変化するため,「SAW 伝搬モードや伝搬方向に合わせて薄膜内の結晶方位や分極方 向を制御する」ことで,初めて高い SAW 位相速度,高い結合係数,低い伝搬減衰を両立 する LLSAW デバイスが達成できると考えた.そこで本研究では,"高い SAW 位相速度・ 高い電気機械結合係数・低い伝搬減衰"の両立を目的とした「結晶方位,分極方向を制御し た希土類 AIN 薄膜 / 圧電単結晶基板構造を用いた縦型漏洩弾性表面波 (LLSAW) デバイス」 の実現 (図1(b)) に向け,以下の研究を行った.

・ScAlN 薄膜の結晶方位制御

・SAW 伝搬理論解析による最適な希土類 AIN 薄膜 / 圧電単結晶基板構造の決定

・希土類 AIN 薄膜 / 圧電単結晶基板構造 LLSAW デバイス作製・評価

2. ScAIN薄膜の結晶方位制御

研究開始前の成果として、スパッタ AIN 成膜中の基板へのスパッタ粒子入射角度およ びイオン照射を制御することで、基板に依存せずに結晶方位・分極方向が制御できること を見出していた. "巨大圧電性希土類 AIN 膜^[3]"の結晶構造はAINとほぼ同じ(ウルツ鉱構 造)であるため、同様の手法で結晶方位制御は可能だと考えた。まずは、図2に示す成膜 装置の構築を行った。通常のスパッタ成膜装置と構成はほとんど同じであるが、スパッタ 粒子の入射角度、イオン照射角度を変化させるために基板角度 a を制御できるような機構 をもつ。加えて、成膜中のイオン照射するために、ECR イオン源を真空チャンバー側面 に装備した。表1に示す条件で ScAIN 成膜、極点 XRD 測定による結晶配向性評価、



図2 本課題で構築したイオンビームアシスト RF マグネトロンスパッタ装置

11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	11/0:0
	AI/SIO ₂
成膜ガス圧(N ₂ :Ar)	0.4 Pa (1:2)
RF電力	140-200 W
成膜時間	4 -5 h
Sc粒量	1.76 - 2.3 g
基板傾斜角度α	0 ° - 90 °
膜厚	2.2 ~ 5.1 μm

表1 成膜条件

EPMA 測定による Sc 濃度測定を行い, ScAlN 薄膜においても AlN と同様に結晶配向制御 が可能であるか調査を行った。また ScAlN 膜薄膜共振子を作製し, ネットワークアナア ナライザによる変換損失測定からすべりモード電気機械結合係数を算出し, Sc 濃度およ び c 軸傾斜角度に対する依存性について評価した。

まずは、スパッタ粒子入射角度 a を 20~90°とし、結晶方位 (c 軸傾斜角度) 制御した ScAlN 膜を形成し、イオンビームなしで成膜可能な c 軸傾斜角度の調査を行った。図3に

各試料での(0002)極点図を示す。基板台傾斜角 度の増加に伴い薄膜内のc軸傾斜角度も増加して いることがわかる。また、基板台傾斜角度を60° とすると、c軸の傾斜角は50°弱となった。基板 台傾斜角度を90°とした時は、面内、面外とも結 晶配向性が著しく低下した。これは、スパッタ粒 子の入射角度が基板に平行になったことで堆積し にくい、かつ、自己陰影効果による膜のポーラス 化が発生したためと考えられる。このことから、 基板台の傾斜のみで作製できるc軸傾斜膜は50° 程度までということがわかった。

次に,低加速電圧 300V で加速したイオンビー ムを成膜中に照射した ScAIN 膜の形成も行った。 (0002) 極点図から配向性評価を行ったところ,



低加速度イオンビーム照射では c 軸傾斜角度はほ とんど変化せず、イオン照射による ScAIN 膜で の c 軸傾斜角度制御は実現できなかった。これは、 装置不良によりイオン加速電圧 300V までに制限 され、AIN で c 軸角度制御に成功した高加速度ビ ーム (数 1000V) が照射できなかったことが主な 要因であると考えられる。

図4に本研究で作製した ScAlN 膜の電気機械 結合係数 k_{15}^2 のc軸傾斜角度依存性を示す。実曲 線はAlN, ScAlNの材料定数を用いて計算した単 結晶の理論曲線である。高濃度 Sc ドープ





(Sc:35%付近) 試料では、AIN 単結晶を超える k_{15}^2 値が得られており、Scドープによる k_{15}^2 値の増幅を確認した。c 軸傾斜角度に注目すると、理論計算通り c 軸傾斜角度 35–40° の間で k_{15}^2 値は最大となり、c 軸傾斜角度 40°かつ Sc 濃度 31%の薄膜で k_{15}^2 =9.9%となった. 一方でイオンビーム照射した ScAIN 薄膜では、同じ c 軸傾斜角度をもつイオンビーム照射なし試料と比較すると、 k_{15}^2 値が約 2 倍程度に増幅するサンプルもあり、イオンビーム照射による ScAIN 薄膜のさらなる圧電性改善の可能性を示した。この要因としては、イオン照射による窒化の促進、結晶歪み、膜の緻密化が挙げられるが、Sc 濃度や c 軸傾斜角度、イオンビーム照射の強度、イオンビームの導入角度など未だ検討されていない部分は多くあり、今後の研究でさらなる調査を行う。

3. SAW伝搬理論解析による最適なScAIN薄膜/圧電単結晶基板構造の決定

高い SAW 位相速度・高い電気機械結合係数・低い伝搬減衰を両立する SAW デバイスには, 「LLSAW 伝搬モード」,「結晶方位・分極方向を制御した巨大圧電性薄膜の圧電単結晶基板 上への装荷」が必要になると考えた. そこで, Farnell と Adler の SAW 伝搬解析法を LLSAW に拡張した方法を用い,装荷する ScAIN 薄膜の Sc 濃度,結晶方位,分極方向,膜厚といっ たパラメータを変化させた時の LLSAW 位相速度,結合係数,伝搬減衰を計算し,LLSAW デバイスに最適な ScAIN 薄膜 / 圧電単結晶基板 (LiNbO₃ および水晶) 構造を決定した.

3.1 ScAIN薄膜/LiNbO3圧電単結晶基板上でのLLSAW伝搬特性^[4]

図5にc軸配向もしくはc軸平行 ScAlN 膜/X カット 36° Y 伝搬 LiNbO₃ 基板上を伝搬 する LLSAW 位相速度, 伝搬減衰, 結合係数の理論解析結果を示す。c軸配向 ScAlN 膜装 荷時の位相速度はh/y<0.04 では増加し, h/y = 0.04 で最大値 (約7700m/s) となる。 h/y<0.04 では減少に転じ,約7350m/s に収束する。伝搬減衰は, h/y>0.1 でゼロ減衰 となる。一方, c軸平行 ScAlN 膜装荷の場合は,位相速度はh/y<0.1 で減少し, h/y = 0.04 で最小値 (約6600m/s) となる。h/y>0.1 では増加する。また伝搬減衰は h/y 増加 に伴い増加することが分かった。結合係数は c 軸平行 ScAlN 薄膜装荷時に 36° Y 伝搬 Xcut LiNhO₃ 単体より大きな値が得られ, h/ λ =0.1 の時最大となり K^2 =21% となった。 この値は LN 単体の約 1.6 倍となった。以上より,LLSAW 伝搬減衰を抑制するためには c 軸配向 ScAlN 膜装荷,結合係数増幅には, c 軸平行 ScAlN 膜装荷が有効であることが分 かった。



図 5 ScAlN 膜 /LiNbO₃ 基板上での LLSAW 位相速度, 伝搬減衰, 結合係数の ScAlN 膜厚依存性の数 値計算結果

次に、ScAlN 薄膜の c 軸傾斜角度が LLSAW の特性に及ぼす影響を評価するために、 (0 θ 90) ScAlN 膜の θ 角度を変化させた時の LLSAW 伝搬特性を理論解析した。図 6 (a)、 (b) に開放状態および境界短絡状態の伝搬減衰、(c) に結合係数を示す。0< h/ λ <0.15 で は θ 角度が大きくなるにつれて、結合係数が大きくなることが確認できた。一方で、結合 係数が LN 単体より大きくなる θ 角度 80 度以上では、ゼロ減衰が得られていないため、 ScAlN/LiNbO₃ 基板構造では結合係数増幅とゼロ伝搬減衰の両立を実現する θ 角度と規格 化膜厚を発見することができなかった。



図 6 ScAlN 膜 /LiNbO₃ 基板上での LLSAW 伝搬減衰,結合係数の ScAlN 膜 c 軸傾斜角度依存性の数 値計算結果

3.2 ScAIN薄膜/水晶圧電単結晶基板上でのLLSAW伝搬特性^[5]

回転 Y カット 45° X 伝搬水晶基板のカット角が LLSAW の結合係数および伝搬減衰に及 ぼす影響を (0° 90° 90°)ScAlN 層 / (0° θ 45°)水晶基板構造での理論解析から評価した。 図 7 (a) に示すように、 θ = 125° において伝搬減衰が極小値を示した。また図 7 (b) に示す



ように θ =125°での K² は 7% 以上を示している。よって ScAIN 層 / 回転 Y カット 45°X 伝搬水晶基板上を伝搬する LLSAW にて低伝搬減衰,高結合係数を得るためには,AT カ ットが最適であることがわかった。次に,各h_{ScAIN}/ λ における (0° 90° 90°)ScAIN/AT カ ット 30-55°X 伝搬水晶基板上を伝搬する LLSAW の位相速度,伝搬減衰,結合係数の理論 解析を行った。図 8 (a) に示す位相速度はすべての構造で h_{ScAIN}/ λ 増加伴い,AT カット水 晶基板の LLSAW 位相速度 (=6,700-7,000 m/s) から減少した。図 8 (b) に示す伝搬減衰は h_{ScAIN}/ λ =0.1 付近で極小値を示した。この伝搬減衰極小値の大きさは水晶の SAW 伝搬方

向に依存し、35°X 伝搬時に最小値 (=0.003 dB/ λ) となった。次に図 10 に各 h_{ScAIN}/ λ における (0° 90° 90°)ScAIN/X カット 30-55°Y 水晶構造上 LLSAW の 位相速度、伝搬減衰、結合係数の理論解析を示す。 位相速度(図 9 (a))および結合係数(図 9 (c))は AT カット水晶基板の場合とほぼ同様の傾向となった。 LLSAW 伝搬減衰はすべての構造で h_{ScAIN}/ λ =0.09 付近で極小値を示した(図 9 (b))。AT カット水晶 を基板とした時と同様に、伝搬減衰極小値の大きさ は水晶の SAW 伝搬方向に依存し、30°Y 伝搬時に最 小値 (=0.0003 dB/ λ) となった。

図 10 に FEM 解析により計算した IDT/(0°90°



図 10 FEM 解析による IDT/ScAIN/ 水晶構造 LLSAW 共振子のアド ミタンス周波数特性

90°) ScAlN 層 /AT35°X および X30°Y 水晶基板でのアドミ ッタンス特性を示す。 h_{ScAlN}/λ は短絡表面での伝搬減衰が 極小値となる $h_{ScAlN}/\lambda = 0.1$ (AT35°X 水晶), 0.09 (X30°Y 水晶)とそれぞれ設定した。両構造とも 800 MHz 付近に 共振特性が観測された。AT35°X 水晶基板の場合は帯域幅 =3.5%、アドミタンス比 = 86 dB、共振 Q=1,990、反共振 Q=2,040、X30°Y 水晶基板では帯域幅 =3.5%、アドミタ ンス比 = 87 dB、共振 Q=2,480、反共振 =2,780 であった。 よって LLSAW 伝搬においては、より高Q 値となった (0° 90° 90°) ScAlN 層 /X30°Y 水晶が最適構造であると考えら れる。

図 11 に FEM 解析による共振周波数での x,y,z 方向の粒 子変位分布 ux,uy,ux を示す。低 Q 値 (= 約 8) となる X カ ット 36°Y 伝搬 LN(図 8 (a)) では, すべての粒子変位が基 板内深い部分でも大きい。一方で, ScAlN/水晶構造(図 8(b,c)) では, 粒子変位が1波長以下の深さに集中しており, LLSAW は ScAlN 層に集中, かつ横波バルク波放射が抑制 されるために, 低伝搬減衰および高 Q 値が得られたと考 えられる。



図 11 FEM 解析による共振周波 数における (a)X36YLiNbO₃ 単体, (b)ScAlN/AT35X 水 晶, (c)ScAlN/X30Y 水 晶 での粒子変位

4. c軸配向AIN薄膜/圧電単結晶基板構造LLSAWデバイス作製・評価^[4]

c軸配向 ScAlN 薄膜 /IDT/LiNbO₃ 圧電単結晶基板構造 LLSAW デバイスの作製を行った。 ScAlN 膜は 2 章で高配向膜の得られた条件(表1)で IDT/LiNbO₃ 基板上に装荷した。ネッ トワークアナライザを用いた周波数特性評価から薄膜を装荷しない従来 SAW デバイスの特 性,および 3-1 章で計算した理論解析結果と比較することで,作製した LLSAW デバイス の優位性,問題点を検討した。図 12 に作製した IDT/X カット 36° Y 伝搬 LiNbO₃ 基板およ び c 軸配向 ScAlN/IDT/X カット 36° Y 伝搬 LiNbO₃ 基板構造を持つ LLSAW デバイスでの 挿入損失最小値の伝搬距離 L 依存性を示す。すべての L で ScAlN 膜を装荷により LLSAW の挿入損失が改善している。また伝搬損失を各曲線から算出すると,装荷なしでは 0.20-

0.25 dB/ λ と大きいが,装荷ありでは0.08-0.10 dB/ λ となり,理論解析で示されたc軸配向ScAlN 膜装荷による伝搬損失の低減は観測できた。しかし, 理論解析のようなゼロ伝搬減衰は観測されなかっ た。この要因をScAlN表面形状と考察し,AFMに より表面粗さ測定を行った。ScAlN 膜表面粗さ R_q は2.7 nmであり,LLSAWの波長(4.8 μ m)より十 分に小さかったため,ScAlN表面形状はゼロ伝搬減 衰が得られなかった要因とは考えづらい。現在は ScAlN とLiNbO₃の界面に存在する結晶構造の不連 続性,不活性層が原因だと考えており,今後は断面 SEM 評価などを行い,原因の解明を行う予定である。



図 12 ScAIN/IDT/LiNbO₃ LLSAW デ バイスでの最小挿入損失の伝 搬距離 L 依存性

5. 結論

ScAlN 成膜中のスパッタ粒子入射角度,イオン照射を制御することで c 軸方向の制御を 試みた。c 軸が最大 50 度傾斜した ScAlN 膜の形成に成功した。また,それらの膜の結合 係数は AlN 単結晶の値よりも大きくなった。

ScAlN 膜を LINbO₃ および水晶上に装荷した場合の LLSAW 伝搬特性の解析を行った。 c 軸平行 ScAlN 膜を LiNbO₃ に装荷した場合,結合係数が増幅する事がわかった。但し、 低伝搬減衰との両立は実現できなかった。一方、c 軸平行 ScAlN 膜を水晶に装荷した構造 では高位相速度,ある程度大きな結合係数,低伝搬減衰が両立することを明らかにした。

6. 参考文献

[1] T. Sato and H. Abe, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Contr. 45, 136 (1998).

[2] F. Matsukura and S. Kakio, Jpn. J. Appl. Phys. 53, 07 KD 04 (2014).

[3] T. Yanagitani and M. Suzuki, Appl. Phys. Lett. 105, 122907 (2014).

- [4] M. Suzuki, M. Gomi, and S. Kakio, Jpn. J. Appl. Phys. 53, 07 LD 06 (2018).
- [5] M. Suzuki, N. Sawada, and S. Kakio, Jpn. J. Appl. Phys. 58, SGGC 08 (2019).